

2018年11月5日

各位

デンカ株式会社  
三菱マテリアル株式会社

### 環境対応車用セラミック絶縁放熱回路基板の共同開発について

デンカ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本学、以下デンカ）と三菱マテリアル株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：小野直樹、以下三菱マテリアル）は、電気自動車に代表される環境対応車のモーター駆動用パワーモジュールに使用されるセラミック絶縁放熱回路基板（以下セラミック基板）についての共同開発に合意して、本格的量産に向けた取り組みを進めておりますので、お知らせいたします。

近年の急速な自動車電動化のニーズの高まりを受け、モーター駆動用パワーモジュールに使用される絶縁放熱部品として、放熱特性に優れたセラミック基板の需要は大きく拡大しています。

一方、モーターの高出力化に伴う半導体素子の発熱密度の増大に対応するため、セラミック基板の銅回路を厚くして更に放熱特性を向上しつつ、熱サイクル信頼性を高めた製品が求められています。

両社は、このたびの共同開発を通して、デンカが持つセラミックの材料技術ならびに製造技術と、三菱マテリアルが持つ独自の回路化工程の技術を融合させることにより、市場競争力の高いセラミック基板の早期製品化を目指してまいります。

以上

**【本件に関するお問い合わせ】**

デンカ株式会社

C S R ・ 広報室 TEL. 03-5290-5511

三菱マテリアル株式会社

総務部広報室 TEL. 03-5252-5206